

주주총회소집공고

2026 년 08 월 10 일

회 사 명 : 주식회사 에이팩트
대 표 이 사 : 이성동
본 점 소 재 지 : 경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26
(전 화) 031-8046-1700
(홈페이지) <http://www.apact.co.kr>

작 성 책 임 자 : (직 책) 재무기획담당 (성 명) 최시영
(전 화) 031-8046-1716

주주총회 소집공고

(제20기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제18조에 의거, 제20기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 제20조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 전자공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일시 : 2026년 08월 25일 (화) 오전 9시
2. 장소 : 경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26, (주)에이팩트 본사 1층 다목적실
3. 회의 목적 사항

가. 부의 안건

제1호 의안 : 이사 선임의 건

제1-1호 의안 : 사내이사 이성동 선임의 건

제1-2호 의안 : 사내이사 성희용 선임의 건

제1-3호 의안 : 사외이사 송유철 선임의 건

제2호 의안 : 감사 선임의 건

제2-1호 의안 : 감사 이진승 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지, 공고사항을 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(<https://dart.fss.or.kr>)에 전자공시 및 당사 홈페이지에 게시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : <https://evote.ksd.or.kr>

모바일 주소 : <https://evote.ksd.or.kr/m>

나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 08월 15일~2026년 08월 24일

- 08월 15일 오전 9시부터 08월 24일 오후 5시까지 24시간 이용 가능

- 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 공동인증서의 종류 : 공동인증서 및

민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 기권으로 처리

※ 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장, 인감증명서, 대리인의 신분증

다. 위임장에 기재할 사항

- 위임인 성명, 주소, 주민등록번호, 인감 날인

- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용
- 라. 위 사항이 충족되지 않을 시 주주총회 입장이 불가할 수도 있으니, 이 점 유의하시기 바랍니다.
- 마. 주총참석장이 없는 주주님께서서는 개인 신분증만 지참하시어 주주총회에 참석하시길 바랍니다.

2026년 08월 10일

주식회사 에이팩트
대표이사 이 성 동

I. 독립이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 독립이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	독립이사 등의 성명	
			윤병진 (출석률: 100%)	정기택 (출석률: 100%)
			찬 반 여 부	
제26-01회차	2026.02.24	1. 제19기(2025년도) 정기주주총회 개최의 건 2. 제19기(2025년도) 정기주주총회 의안 확정 의 건 3. 2026년도 사업계획 승인의 건	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성
제26-02회차	2026.03.10	※ 보고사항	-	-
제26-03회차	2026.03.27	1. 시설자금 차입의 건 (연장) 2. 운영자금 차입의 건 (연장)	찬성 찬성	찬성 찬성
제26-04회차	2026.05.20	1. 이사회 의장 선임의 건 2. 운영자금 차입의 건 (연장)	찬성 찬성	찬성 찬성
제26-05회차	2026.05.29	1. 2026년 사업계획 승인의 건 (Revision) 2. 운영자금 차입의 건 (신규) 3. 제5회 전환사채 발행의 건	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성
제26-06회차	2026.06.23	1. 운영자금 차입의 건 (연장) 2. 운영자금 차입의 건 (신규) 3. 운영자금 차입의 건 (신규)	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성
제26-07회차	2026.07.16	1. 제20기(2026년도) 임시주주총회 개최의 건 2. 제20기(2026년도) 임시주주총회 의안 확정 의 건	찬성 찬성	찬성 찬성

나. 이사회내 위원회에서의 독립이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 독립이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	1,500	36	18	-

* 주총승인금액은 사내이사 보수가 포함된 금액입니다.

* 지급총액은 2026년 상반기에 지급된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정 규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 반도체 후공정 산업

① 반도체 패키징 산업

반도체 패키징 기술은 반도체 칩을 최종 제품화하는 공정으로 회로설계 기술, 웨이퍼 공정기술과 함께 반도체를 만드는 3대 핵심기술 중의 하나입니다.

반도체 패키징이란 전공정이 끝난 반도체 웨이퍼로부터 칩을 절단한 후 (Sawing 공정), 칩의 전기적 특성 등이 회로 부품이나 인쇄 회로 기판에 전달될 수 있도록 연결(Die Attach, Wire Bonding 공정)하고 외부 환경으로부터 보호하기 위한 성형(Molding 공정)을 하는 공정입니다. 일반적인 구조는 실리콘 칩(Silicon Chip)과 기판(Substrate) 그리고 전기적 연결을 위한 금속와이어와 솔더 볼 등으로 구성되며, 부품 고정과 최종 제품 성형을 위한 접착제와 몰딩 컴파운드 등이 사용됩니다.

반도체 패키징 산업은 반도체 테스트 산업과 함께 반도체산업의 후공정 분야로 분류되며 종합반도체 회사 및 팹리스업체들로부터 수주를 받아 납품하는 사업구조입니다. 각 패키지별 제조설비 및 공정 보유여부, 공정 및 설비기술 대응능력, 주문에 따른 단납기 대응능력, 엄격한 품질관리 능력 및 원가수준 등이 패키징업체의 경쟁력을 결정짓는 주요 요소들입니다.

② 반도체 테스트 산업

후공정은 크게 개별 칩별로 전기적 신호를 연결하고 형상 가공의 역할을 하는 패키징 공정과 반도체 소자의 전기적 기능을 검사하는 테스트 공정으로 분류되며, 테스트 공정은 다시 패키징 이전 단계인 웨이퍼 상태에서 진행되는 웨이퍼 테스트(Wafer Test)와 패키징 공정 완료 후 완성된 개별 칩에 대한 검사를 수행하는 패키지 테스트(PKG Test)로 구분됩니다.

테스트 산업을 포함하는 반도체 후공정 산업은, 산업초기 종합 반도체 제조사들이 비핵심 제품의 생산 물량 일부를 외주로 전환하는 형태로 시작되었으나, 이후 공정 기술의 미세화 등 기술이 고도화되고 이에 따른 투자 비용이 급증함에 따라, 외주비중을 증가시키면서 성장하기 시작하였습니다.

더불어 빠른 기술 진화로 제품의 라이프 사이클이 짧아지고 연구개발에 대한 부담이 증가하면서 산업의 전문화, 세분화 필요성이 대두되고, 이를 기반으로 설계를 전문으로 하는 팹리스 업체가 성장하기 시작하였습니다. 팹리스 업체는 설계 이외의 모든 공정에 대해 외주를 기반으로 하기 때문에 팹리스 업체의 성장은 웨이퍼 전문제조업체인 파운드리를 비롯하여 패키징, 테스트 등 후공정 산업의 성장을 견인하고 있습니다.

[반도체 공정에 따른 산업 분류]

구분	특징	주요 국내(해외)기업
----	----	-------------

종합반도체기업(IDM)		- 설계, 가공, 조립, 마케팅을 일괄수행- 대규모 R&D 및 설비투자 필요	삼성전자, SK하이닉스 (Intel)
전공정	설계 전문기업 (Fabless)	- 칩의 설계만 담당(IP병행도 가능)- 생 산설비 없는 IC 디자인 전문회사 - 고위 형의 거대투자 회피할 수 있으나 위탁제 조 비용부담 필요 - 창의적인 인력 및 기 술력 필요 - 고도의 시장 예측 및 주문수 량 최소화 필요	실리콘웍스, 텔레칩스, 실 리콘화일, 티엘아이, 아이 엔씨 등(Qualcomm, Nvidia, Broadcom, Mediatek, XILINX,)
	제조 전문기업 (Foundry)	- Wafer 가공 및 Chip제조 전문기업- 설 계전문 업체로부터 위탁제조 - 대규모 설 비투자 및 적정생산규모 필요	동부하이텍 등(TSMC, UMC, SMIC)
후공정	조립 전문기업 (Packaging)	- 가공된 Wafer 조립/패키징 전문 - 축적 된 경험 및 거래선 확보 필요	하나마이크론, SFA반도체, 시그네틱스 등 (ASE, Amkor)
	테스트 전문기업 (Testing)	- 검사장비가 고가이므로 테스트 전문업 체에 위탁 - 시스템 IC 중 전문화된 테스 트 팹리스 업체 개발시 개발지원 테스트 프로그램 개발	아이텍반도체, 테스나, 원 팩, 에이팩트 등(KYEC, ASE TEST)

* 자료 : KIET, 산업연구원

반도체 후공정 산업은 특성상 다수의 고가 장비에 대한 투자가 선행되어야 하는 장치산업으로, 요구하는 기술 수준이 반도체 제조사의 반도체 생산기술과 동조화되는 경향을 보이고 있어 지속적인 연구개발을 필요로 하며, 이를 양산하기 위한 적시 투자를 필요로 합니다.

또한 제품의 신뢰성 확보가 매우 중요한 경쟁력이므로, 반도체 후공정 개발을 위한 엔지니어 보유와 다양한 제품을 처리할 수 있는 기술력 및 높은 품질 수준을 필요로 하며, 이를 충족하기 위해서는 장기간의 운영 경험 및 고객사와의 신뢰관계가 요구됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

① 반도체 패키징 부문

당사가 영위하고 있는 반도체산업의 후공정 분야는 반도체 패키징 및 테스트 공정으로 구성되어 있으며, 소수의 종합반도체 회사 중심으로 구성된 메모리 위주의 국내 반도체 산업의 특성상 종합반도체 회사들의 생산계획 및 수주에 의존적인 사업구조를 보이고 있습니다. 과점화되어 있는 대기업 중심의 패키징 수요산업에 비해 패키징 산업은 다국적 기업의 현지법인과 소수의 국내 중소기업으로 공급시장이 형성되어 있습니다. 대부분의 패키징 업체들의 주요 매출처가 삼성전자와 SK하이닉스이기 때문에 패키징 산업 자체가 소수의 업체에 의해 과점화되어 있지만, 수주 물량 확보를 위한 경쟁이 치열하게 전개되고 있으며, 각 패키징별 제조설비 및 공정 보유여부, 공정 및 설비기술 대응능력, 주문에 따른 단납기 대응능력, 엄격한 품질관리 능력 및 원가수준 등이 패키징 업체의 경쟁력을 결정짓는 주요 요소들이라고 볼 수 있습니다.

당사의 주요 매출처는 SK하이닉스, 삼성전자, LX세미콘, 실리콘마이터스, 제주반도체, 동심반도체 등 국내, 해외 대형 IDM업체에서부터 중소형 팹리스업체까지 다양한 고객군을 확보하고 있으며, 품질분석 능력에 기반한 품질관리 능력과 중고 장비 도입을 통한 고정비용 절감 및 원가경쟁력 확보, 수요처의 Needs에 기반한 적극적인 납기 대응 능력과 설립 이후 이와 같은 경쟁력을 통해 주요 매출처와 쌓아온 신뢰관계를 기반으로 지속적인 매출을 실현하고 있습니다.

또한, 기존의 대기업 위주의 편중적인 매출 구조의 한계를 극복하고, 매출처 다변화를 통한 교섭력 강화 및 수익성 확보를 위해 노력한 결과, 해외시장 공략에도 성공하여 지속적으로 해외고객 매출이 발생하고 있습니다. 또한, 기존 제품군이 메모리 중심에서 비메모리 반도체로, 전통적인 1세대 패키지인 DIP, SOP 제품 군에서 차세대 고부가가치 패키지인 BGA, FC, QFP로 확대되는 등 사업 구조의 질적인 변화를 통해 주력시장의 성장기회를 향유할 수 있는 다양한 확장 및 성장의 축을 확보하였습니다.

② 반도체 테스트 부문

반도체 테스트는 반도체 소자(IC)의 전기적인 특성을 검사하는 것으로 시스템으로 구축된 프로그램 내에서 그 성능이 제대로 구현되는 지를 확인하는 공정으로 반도체 칩(Chip)이 탑재된 QFP, BGA, SiP등과 같은 제품화된 패키지를 테스트 하는 공정입니다.

당사는 Wafer의 두께를 얇게 만드는 Back Grind 공정에서부터 패키징 및 테스트 단계에 이르기까지 후공정 관련 Total Solution을 제공할 수 있는 일괄 생산체제를 구축하였으며, 설립초기부터 메모리 반도체 테스트 사업뿐만 아니라 시스템 반도체 테스트 사업에도 주력하여 국내에서 유일하게 MCP(Memory+ System IC) 반도체의 테스트가 가능한 기반을 구축하였습니다.

테스트 사업부는 패키징 사업부와와의 시너지 효과를 통해 Turn-Key 서비스를 제공할 수 있는 경쟁력과 기술력 향상 및 품질 개선 등 경쟁회사 대비 비교우위를 창출할 수 있는 경쟁력의 한 축으로 역할을 할 것으로 기대되고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 반도체 후공정 사업을 영위하고 있으며, 공시대상으로 구분되는 사업부문은 없습니다.

(2) 시장점유율

국내 반도체 후공정 산업인 테스트 사업은 소수의 업체들이 과점체제를 이루고 있으며, 또한 공신력있는 기관에서 생성한 객관적인 시장점유율이 존재하지 않아, 별도로 표기하지 아니합니다.

(3) 시장의 특성

○ 대규모 설비 투자 사업 및 규모의 경제 실현

반도체 후공정 산업은 장치산업에 속합니다. 고가의 장비를 설치하여야만 양산이 가능하며, 양산 능력의 조절도 추가 장비 구매에 의해 가능합니다. 장치 산업의 특성상 초기 투자가 필수적이며, 어느 정도 규모의 경제를 실현하기까지는 계속적인 투자가 필요합니다. 반도체 후공정 장비 외에도 반도체 후공정 생산을 위한 Clean Room 등 대규모 Utility 시설도 갖추어야 합니다.

특히, 최근에는 다양한 제품 및 공정발달로 인하여 다양한 테스트 장비군을 형성하는 것이 가장 중요한데, 산업이 성장하면서 다양한 제품이 출시되어 시장의 특성상 이들 제품에 대해서 대응하기 위해선, 그 제품에 맞는 제품군을 형성하여 시장을 선도해야 합니다. 자본의 축적에 의한 규모의 경제는 후발주자의 진입장벽이 됩니다.

○ 기술력의 보유

반도체 후공정 산업은 반도체 후공정에 대한 기술 집약적 산업이며, 다양한 칩들에 대한 패키징 기술, 테스트 프로그램 개발 능력 및 경험이 다른 공정에 비해 절실히 필요한 산업입니다. 연구 개발자의 기술 및 경험에 따라 후공정의 품질이 크게 달라지므로, 핵심 기술 인력의 보유가 후공정 산업의 큰 경쟁력이 됩니다.

미세공정의 발달 등 제품의 다양화는 기술적인 노하우와 다양한 제품에 대한 이해도를 가진 엔지니어의 확보는 경쟁업체 뿐만 아니라 후발 주자에게는 큰 진입장벽이 됩니다.

○ 제조 운용 능력 인프라의 구축

반도체 후공정 외주산업은 납기 및 품질의 중요성이 무엇보다 중요한 사항이며, 이를 위해서는 정확하고 종합적인 분석 시스템이 있어야 실시간 모니터링과 코스트에 가장 민감한 수율(YIELD)을 관리할 수가 있습니다.

이를 위해서는 반도체공정을 이해하고 고객이 원하는 다양한 데이터에 대한 출력이 실시간 피드백이 되어야 하는데, 이를 구현하기 위해서는 다년간의 인프라 구축과 반도체 제조에 대한 분석 툴이 개발 축적되어야 하며, 이런 인프라는 IDM 혹은 해외의 유수 업체 등 종합적인 제조 능력을 가진 파트너와의 장기간 교류 없이는 달성될 수 없는 부분입니다.

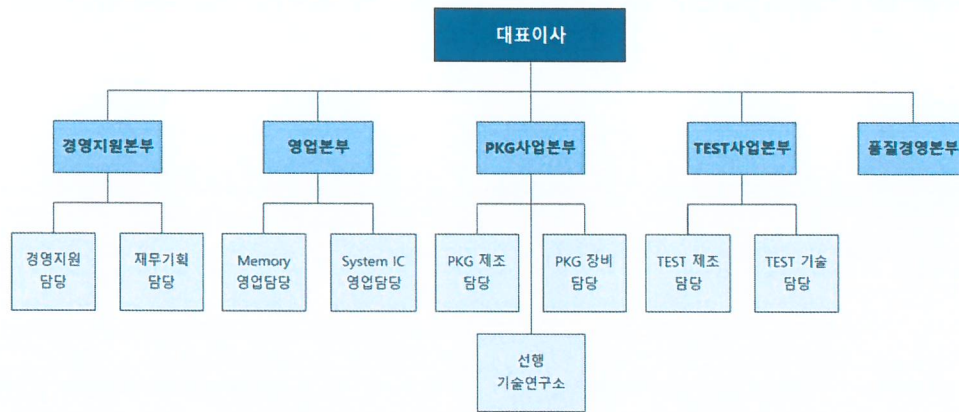
○ 품질 경쟁력

반도체 후공정은 반도체 공정의 마지막 공정으로 품질 경쟁력이 무엇보다 중요합니다. 반도체 후공정에서 품질 결함이 발생할 경우 고객에게 직접적으로 Complain이 발생하기 때문에, 고객을 만족시키기 위해서는 엄격한 품질 기준과 공정관리를 통한 지속적인 개선이 필요하며, 품질 경영 시스템 구축을 통해 신뢰할 수 있는 제품과 서비스를 고객에게 제공하며, 품질 신뢰 구축을 위해 품질/환경/안전 등의 품질인증을 취득하여 품질 경영 시스템 구축을 지속적으로 진행하여야 합니다. , 고객의 엄격한 품질 수준과 신뢰 구축은 후발주자에게는 큰 진입장벽이 됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2025년 10월 비상장사 글로벌아아엔씨 지분 30%를 취득하면서, 반도체, 디스플레이 전공정 소모품인 Heating Jacket 사업을 영위할 계획입니다.

(5) 조직도



2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·독립이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	독립이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이성동	1965.03.04	부	부	해당사항없음	이사회
성회용	1964.01.04	여	부	해당사항없음	이사회
송유철	1962.06.12	여	부	해당사항없음	이사회
총 (3) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
이성동	에이팩트 대표이사	1988~2018 2019~현재	SK하이닉스 PKG&TEST 제조기술 담당 에이팩트 대표이사	-
성회용	-	2020~2023 2023~2024 2024~2025 2025~2026	SBS 보도본부 논설위원 태광그룹 티캐스트 대표이사 태광그룹 태광산업 대표이사 태광그룹 고문	-
송유철	동덕여자대학 교수	2006~현재 2012~현재 2014~현재 2023~현재	동덕여자대학교 국제경영학과 교수 한국국제경제학회 이사 한국국제통상학회 부회장 외교부 정책자문위원회 경제분과위원회 위원	-

다. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
-------	---------	-------------	--------------

이성동	부	부	무
성회용	부	부	무
송유철	부	부	무

라. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)

[전문성과 독립성]

○ 회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 금지와 책임감을 가지고 전문분야의 근무 경험과 관련 지식 등에 근간한 전문성을 살려 이사회 및 소속 위원회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하고자 함.

○ 또한, 이사회로부터 전문성을 인정 받아 추천 받은 사외이사로서 대주주 및 대주주 관련회사로부터 독립적인 지위에서 전문지식을 통한 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 하고자 함.

[의무]

○ 회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합법적이며 합리적인 해결방안을 모색하고자 함.

○ 특히 이사회에 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 법률적 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함.

○ 주주, 종업원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내/외부의 다양한 정보원(源)으로부터 정보를 수집 하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 회사업무를 결정하고자 함.

[윤리성]

○ 사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 특히 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않음.

○ 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며 직무수행과 관련하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지함.

○ 회사에 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력을 행사하거나 업무에 개입하지 않음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 풍부한 경영 경험과 전문 지식을 갖추고 있어, 당사의 경영활동 참가에 적합하며, 중장기적인 기업 성장에 충분한 기여가 될 것으로 판단되어 추천

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

제3-15조(참고서류)

③ 제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

3. 이사 선임의 경우

가. 후보자의 성명, 생년월일, 주된 직업 및 세무 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자의 해당 법인과의 최근 3 년간의 거래내역, 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 재무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약 등(후보자가 동 계약 등을 체결한 경우 또는 동 계약 등을 체결한 법인, 사무소 등에 동 계약 등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약 등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

2026 년 08 월 10 일

보고자 : 이시중 (서명 또는 날인)

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

제3-15조(참고서류)

③ 제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권으 발행회사 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

3. 이사 선임의 경우

가. 후보자의 성명, 생년월일, 주된 직업 및 세무 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자의 해당 법인과의 최근 3 년간의 거래내역, 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 재무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약 등(후보자가 동 계약 등을 체결한 경우 또는 동 계약 등을 체결한 법인, 사무소 등에 동 계약 등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약 등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

2026 년 08 월 10 일

보고자 : 성 회 용

(서명 또는 날인)


확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15 조 제 3 항 제 3 호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

제 3-15 조(참고서류)

③ 제 1 항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1 에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권으 발행회사 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

3. 이사 선임의 경우

가. 후보자의 성명, 생년월일, 주된 직업 및 세무 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주의 관계

라. 후보자의 해당 법인과의 최근 3 년간의 거래내역, 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 재무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약 등(후보자가 동 계약 등을 체결한 경우 또는 동 계약 등을 체결한 법인, 사무소 등에 동 계약 등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약 등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

2026 년 08 월 10 일

보고자 : 송 유철



(서명 또는 날인)

※ 기타 참고사항 : 해당사항없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이진승	1974.02.10	해당사항없음	이사회
총 (1) 명			

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의
		기간	내용	최근3년간 거래내역
이진승	한우리 장학재단 이사	2019~2020 2019~2021 2019~2022 2013~ 현재	MP그룹, 이사 MP한강, 대표이사 동부지방법원, 민사조정위원 (재)한우리장학재단, 이사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이진승	부	부	무

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

회사 경영 및 법률 지식을 바탕으로 당사의 감사업무를 함에 있어 공정하고, 객관적으로 직무수행을 할 것으로 판단되어 감사로 추천

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 및 제5호의 아래 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

제3-15조(참고서류)

③ 제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

3. 이사 선임의 경우

가. 후보자의 성명, 생년월일, 주된 직업 및 세무 경력사항

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자의 해당 법인과 최근 3 년간의 거래내역, 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 재무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자 문계약 또는 이와 유사한 계약 등(후보자가 동 계약 등을 체결한 경우 또는 동 계약 등을 체결한 법인, 사무소 등에 동 계약 등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약 등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

5. 감사 선임의 경우

가. 제3호 가목, 다목 및 라목

2026 년 08 월 10 일

보고자 : 이진승

(서명 또는 날인)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	-
-------------	---

※ 기타 참고사항 : 해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
-	-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부는 해당사항이 없습니다.

※ 참고사항

[전자투표에 관한 사항]

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였으니, 자세한 내용은 본 공고 본문을 참조하시고, 이에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

주주총회 참석장

주식회사 에이팩트 귀중

- 주 주 명 :
- 주 소 :
- 주민등록번호 :
- 법인등록번호 :
- 소유 주식수 :

본 주주는 하기 일시에 개최된 주식회사 에이팩트의 제20기 임시주주총회에 참석하였음을 확인합니다.

- 개 최 일 시 : 2026년 08월 25일 화요일 오전 9시
- 개 최 장 소 : 경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26
(주)에이팩트 본사 1층

2026년 08월 25일

주주 _____ (인)

위임장

본인은 2026년 08월 25일에 개최하는 (주)에이팩트의 제20기 임시주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 (주)에이팩트가 지정하는 최시영 1인을 그 대리인으로 정하고, 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

= 다 음 =

1. 주주번호 :
2. 소유주식수 :
3. 의결권 있는 주식수 :
4. 위임할 주식수 :
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

번호	주주총회 목적사항	찬성	반대
제1호	이사 선임의 건		
	제1-1호 의안 사내이사 이성동 선임의 건		
	제1-2호 의안 사내이사 성회용 선임의 건		
	제1-3호 의안 사외이사 송유철 선임의 건		
제2호	감사 선임의 건		
	제2-1호 의안 감사 이진승 선임의 건		

6. 새로 상정된 안건이나, 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사 위임

주주총회 시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

다만, 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 내 용

※ 각 의안에 대한 찬반표시가 분명하지 아니하거나 백지위임장은 해당 의안의 표결에 있어 무효 처리될 수 있습니다. 그러나, 전자투표, 전자위임장과 서면위임장 교부가 함께 이루어지고 각 의안에 대한 의견이 서로 모순되는 경우에는 결의 전까지 별도의 의사표명이 없는 경우에는 서면위임장에 해당하는 의사에 따라 의결권을 행사하신 것으로 보겠습니다.

주 주 명 : (인)

주민등록번호(법인등록번호) :

위임일자 및 위임시간 : 2026년 월 일 시